

## 常用元器件手工焊接温度要求表

注：以下所列的时间和温度均为每个焊点焊接的时间和温度,有特殊温度要求的按相应工艺文件的要求进行

一. 元器件类:			
名称	焊接温度	焊接时间	备注
高密引脚 IC (脚距<2mm)	350±10℃	≤3 秒	有防静电要求
低密引脚 IC (脚距≥2mm)	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
光耦	350±10℃	≤3 秒	有防静电要求
MOS 管	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
普通晶体管	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
红外光管	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
发光二极管	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
晶振	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
电阻	300±10℃	≤5 秒	有防静电要求
电容	300±10℃	≤5 秒	有防静电要求
电感	300±10℃	≤5 秒	有防静电要求
高密排针插座 (脚距<2mm)	350±10℃	≤3 秒	有防静电要求
低密排针插座 (脚距≥2mm)	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
二. 导线类:			
规格	焊接温度	焊接时间	备注
42#—30#线	275±10℃	≤3 秒	有防静电要求
28#线	300±10℃	≤3 秒	有防静电要求
26#线	300±10℃	≤5 秒	有防静电要求
24#线	300±10℃	≤5 秒	有防静电要求
22#线	300±10℃	≤6 秒	有防静电要求
20#线	300±10℃	≤6 秒	有防静电要求
18#线	350±10℃	≤8 秒	不宜直接焊于线路板
16#线	350±10℃	≤8 秒	不宜直接焊于线路板
14#线	350±10℃	≤10 秒	不宜直接焊于线路板
三. 金属结构件类:			
钢(铁)导管	450±10℃	≤20 秒	外径≤Φ5